

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2026-004

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、本期业绩预告情况

#### (一) 业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### (二) 业绩预告情况

业绩预计：同步上升

1、经财务部门初步测算，预计合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 27,500 万元至 29,500 万元，与上年同期相比，将增加 11,430.47 万元至 13,430.47 万元，同比增长 71.13%至 83.58%。

2、预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 26,400 万元至 28,400 万元，与上年同期相比，将增加 11,543.22 万元至 13,543.22 万元，同比增长 77.70%至 91.16%。

#### (三) 本次业绩预告未经注册会计师审计

## 二、上年同期业绩情况

(1) 2024 年度，公司归属于母公司所有者的净利润：16,069.53 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：14,856.78 万元。

(2) 基本每股收益：1.23 元。

## 三、本期业绩变化的主要原因

2025 年度，公司净利润预计实现较快增长，主要得益于公司在高端 PCB 及泛半导体领域的持续突破与深化布局。全球人工智能算力爆发、汽车电子化趋势共同驱动 PCB 产业向高多层、高密度技术快速迭代，公司作为全球直写光刻设备龙头，高端 LDI 设备精准匹配市场升级需求，订单需求旺盛，产能利用率维持高位。与此同时，公司高精度 CO<sub>2</sub>激光钻孔设备已获头部客户采纳，显著拓展了产品矩阵与市场空间。在泛半导体业务方面，面向先进封装、板级封装的设备陆续获得重复订单并实现交付，半导体业务逐步放量，成为新的增长动力。此外，公司二期生产基地的顺利投产进一步保障了高端设备的及时交付能力，共同推动公司业绩迈上新台阶。

## 四、相关风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

## 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日